

## SEM像シャープネス評価用Wドットアレイ試料C調達に関する仕様

本仕様は当協会の指定するSEM像シャープネス評価用Wドットアレイ試料Cを調達するための公募に際して適用するものです。納入を希望する機関はA.項に示す期限までに当協会担当者に連絡をお願いします。

### 調達試料仕様

#### 1. 試料Cについて

- ・300mmシリコンウェハ上にプロセス条件Cで作成されたWドットアレイ群から得られる3項の要件を満たす試料を指す。(参考資料あり)

#### 2. 納入数量

- ・1式

#### 3. 試料の要件

- ・内部吸収型レーザとテープエキスパンドを用いたステルスダイシング法により、上記シリコンウェハからそれぞれチップングなしに切出されていること
- ・大きさは7mm角であること
- ・作業はクリーンルーム環境で行うこと
- ・その他、試料の具備する要件の詳細は業者選定後の技術的協議の上決定する。

#### A. 希望納期

2018年1月31日

#### B. 見積もり書提出期限

2016年12月15日17:00までに見積書を添えて下記まで連絡して下さい。

担当：一般社団法人 研究産業・産業技術振興協会 調査研究部 嵩 比呂志

連絡先：東京都文京区本郷3-23-1 クロセビア本郷ビル2F

TEL 03-3868-0826、E-mail suu@jria.or.jp

以上

評価用 W ドットアレイ試料 C のイメージ

